



Title of Change:	PQ DFN8 drivers capacity expansion in OSPI Tarlac turnkey enablement	
Proposed First Ship date:	15 February 2020	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Elmer.Milar@onsemi.com>	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	Products assembled in OSPI Tarlac will have a Month Code marking of "M "	
Change Category:	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input checked="" type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____	
Change Sub-Category(s):	<input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Tarlac City, Philippines	External Foundry/Subcon Sites: None
Description and Purpose:		
	Before Change Description	After Change Description
Assembly Site	UTAC (TH3) Thailand Seremban SBN Mold Compound = MC G700LTD	UTAC (TH3) Thailand Seremban (SBN) OSPI Tarlac (PHM) All Assembly BOMs are going to be the same except for the Mold Compound. Mold Compound (Tarlac) = MC G770 HMD
Test Site	UTAC (TH6) Thailand Seremban SBN	UTAC (TH6) Thailand Seremban (SBN) OSPI Tarlac (PHM)

**Qualification Plan:**

QV DEVICE NAME: NCP81258MNTBG

RMS: 57784

PACKAG:E DFN8 2*2*0.9

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta= <u>125</u> °C, @ 1.2x Nominal not to exceed max rated Vcc	<u>1008</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= <u>150</u> °C	<u>1008</u> hrs
TC+PC	JESD22-A104	Ta= - <u>65</u> °C to + <u>150</u> °C	<u>500</u> cyc
HAST+PC	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	<u>192</u> hrs
uHAST+PC	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	<u>96</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL <u>1</u> @ <u>260</u> °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JESD22-B102/J-STD-002D	Ta = 245C, 20 Dwell time	
PD	JESD22-B100	Applicable POD/Case Outline	

Estimated date for qualification completion: 20 September 2019

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
NCP81258HMNTBG	NCP81258
NCP81258MNTBG	NCP81258
NCP81258FDMNTBG	NCP81258
NCP81258FHMNTBG	NCP81258
NCP5901BMNTBG	NCP81258
NCP5901MNTBG	NCP81258
NCP81151BMNTBG	NCP81258
NCP81151MNTBG	NCP81258
NCP81151FHMNTBG	NCP81258
NCP81151FDMNTBG	NCP81258

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22724X

発行日 : 15 August 2019

変更件名:	OSPI タルラックのターンキー イネーブルメントにおける PQ DFN8 ドライバの能力拡大										
初回出荷予定日:	15 February 2020										
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Elmer.Milar@onsemi.com> にお問い合わせください。										
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。										
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。										
変更部品の識別:	OSPI タルラックで組み立てられた製品には、「M 」という月コードがマーキングされます。										
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input checked="" type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他										
変更サブカテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____										
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Tarlac City, Philippines	外部製造工場 / 下請業者拠点: なし									
説明および目的:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>組立拠点</td> <td>UTAC (TH3) Thailand Seremban SBN モールド・コンパウンド= MC G700LTD</td> <td>UTAC (TH3) Thailand Seremban (SBN) OSPI Tarlac (PHM) モールド・コンパウンドを除き、すべての組立材料は同様になります。 モールド・コンパウンド(Tarlac) = MC G770 HMD</td> </tr> <tr> <td>検査拠点</td> <td>UTAC (TH6) Thailand Seremban SBN</td> <td>UTAC (TH6) Thailand Seremban (SBN) OSPI Tarlac (PHM)</td> </tr> </tbody> </table>			変更前の表記	変更後の表記	組立拠点	UTAC (TH3) Thailand Seremban SBN モールド・コンパウンド= MC G700LTD	UTAC (TH3) Thailand Seremban (SBN) OSPI Tarlac (PHM) モールド・コンパウンドを除き、すべての組立材料は同様になります。 モールド・コンパウンド(Tarlac) = MC G770 HMD	検査拠点	UTAC (TH6) Thailand Seremban SBN	UTAC (TH6) Thailand Seremban (SBN) OSPI Tarlac (PHM)
	変更前の表記	変更後の表記									
組立拠点	UTAC (TH3) Thailand Seremban SBN モールド・コンパウンド= MC G700LTD	UTAC (TH3) Thailand Seremban (SBN) OSPI Tarlac (PHM) モールド・コンパウンドを除き、すべての組立材料は同様になります。 モールド・コンパウンド(Tarlac) = MC G770 HMD									
検査拠点	UTAC (TH6) Thailand Seremban SBN	UTAC (TH6) Thailand Seremban (SBN) OSPI Tarlac (PHM)									



認定計画:

デバイス名: NCP81258MNTBG

RMS: 57784

パッケージ: DFN8 2*2*0.9

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta= <u>125</u> °C, @ 1.2x Nominal not to exceed max rated Vcc	<u>1008</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= <u>150</u> °C	<u>1008</u> hrs
TC+PC	JESD22-A104	Ta= - <u>65</u> °C to + <u>150</u> °C	<u>500</u> cyc
HAST+PC	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	<u>192</u> hrs
uHAST+PC	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	<u>96</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL <u>1</u> @ <u>260</u> °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JESD22-B102/J-STD-002D	Ta =245C, 20 Dwell time	
PD	JESD22-B100	Applicable POD/Case Outline	

認定完了予定日 : 20 September 2019

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NCP81258HMNTBG	NCP81258
NCP81258MNTBG	NCP81258
NCP81258FDMNTBG	NCP81258
NCP81258FHMNTBG	NCP81258
NCP5901BMNTBG	NCP81258
NCP5901MNTBG	NCP81258
NCP81151BMNTBG	NCP81258
NCP81151MNTBG	NCP81258
NCP81151FHMNTBG	NCP81258
NCP81151FDMNTBG	NCP81258